株式会社フジミインコーポレーテッド　株主通信

FUJIMI TODAY

vol. 35

2012年12月発行

2012.4.1〜2012.9.30

特集　フジミの海外市場展開

つよく、やさしく、おもしろい FUJIMI

証券コード 5384





半導体産業のグローバル化の進展とそれに伴う技術革新は
今後さらに加速していくと考えられます。
フジミはお客様の個々のニーズにより早く、より正しく対応することを
目指し、全世界のお客様との信頼関係を作り上げていきます。

代表取締役社長　関　敬史

Top Message

当社グループを取り巻く環境は、欧州の債務問題を起因とした景気低迷、米国景気の成長鈍化や新興国の景気減速などにより全般的に停滞感が強く、先行きについても依然として不透明な状況が続いております。

半導体市場につきましては、第1四半期連結会計期間（4月から6月）においては在庫調整の一巡により持ち直しの動きが見られたものの、第2四半期連結会計期間（7月から9月）に入り、従来型パソコンや薄型テレビ等の最終製品の販売不振の影響を受け、減速傾向となりました。

こうした状況下、当社グループでは、非半導体関連の新規海外需要伸長による売上拡大とコスト削減に努めた結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高16,959百万円（前年同期比15.9%増）、うち製品売上高16,855百万円（前年同期比16.5%増）となりました。また、利益面では、営業利益2,740百万円（前年同期比173.6%増）、経常利益2,746百万円（前年同期比168.7%増）、四半期純利益1,714百万円（前年同期比149.1%増）となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、半導体市場の需要減少等によりラッピング材の売上高は1,648百万円（前年同期比2.2%減）、ポリシング材の売上高は3,195百万円（前年同期比17.9%減）となりました。

CMP向け製品につきましては、最先端ロジックデバイス向け製品の販売が増加し、売上高は4,399百万円（前年同期比11.3%増）となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、アジアでの販売が増加したものの、グループ全体としては従来型パソコンの低調な出荷状況等により、売上高は887百万円（前年同期比2.7%減）となりました。

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、販売が順調に拡大したことから、売上高は5,583百万円（前年同期比100.5%増）となりました。

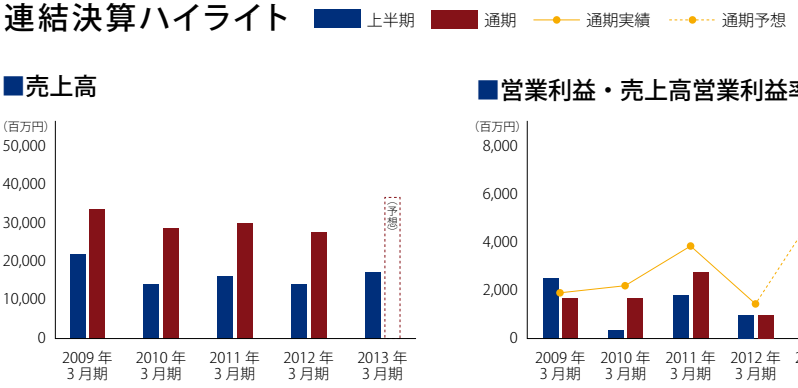
下半期については、長期化する欧州経済の停滞や新興国の景気減速等から、世界経済の悪化懸念が高まっています。半導体市場においても、依然として従来型パソコンやデジタル家電等の最終製品の世界需要が低調であるなど予断を許さない状況にあります。

当社グループはこの厳しい事業環境の中、変化にいち早く対応することにより半導体関連事業はもとより、非半導体関連事業の売上拡大に向け、引き続き注力してまいります。

2009年に策定した9ヵ年の中長期経営計画は、第一期から第三期までの三段階に分かれており、前期までの3年間は第一期<基盤整備>として、新たなる成長に向けて基礎固め・体制作りをしてきました。

当期からの3年間は、第二期<基盤強化>となり第一期でまいた大切な種をきちんと育ててまいります。

連結決算ハイライト



特集 フジミの海外市場展開

今回は、フジミの海外市場展開についてご紹介します。
前半では、フジミグループを中心に、後半では、来年から本格稼働する台湾をはじめ
アメリカ、マレーシア、ヨーロッパにおける海外拠点の活動についてご紹介します。

キーワードは、“お客様との信頼関係づくり”

フジミの海外進出は、1984年のアメリカ進出に始まり、その後、アセアン拠点としてのマレーシア、ヨーロッパ拠点としてのドイツ、そして来年には台湾での本格稼働へと広がっています。

各拠点づくりにおいて、最も重視してきたことは、“お客様との信頼関係づくり”です。お客様に最高の品質を提供し続けるため、お客様の利便性を最優先に拠点を構え、お客様と緊密な連携を実現してきました。

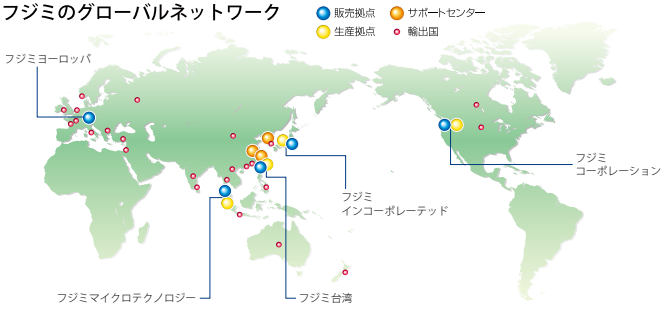
現在、海外市場展開を行う上で、製品開発のスピードアップが重要な課題です。例えばこれまでは**国際半導体技術ロードマップ**に沿って、技術進歩をある程度見通すことができました。しかし、今はその国際半導体技術ロードマップを超えるスピードで技術が進歩しており、お客様の技術動向をより早く把握し、いかに製品開発につなげるかが重要となっています。

一方、お客様の製造拠点は、アジアへと移ってきています。

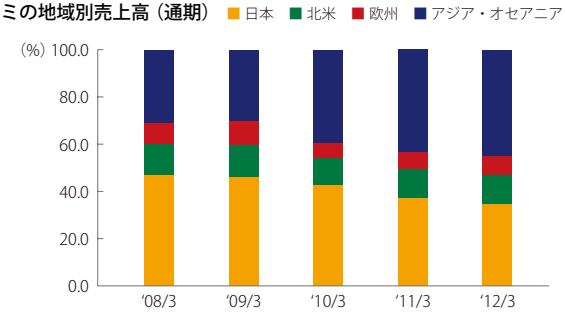
フジミのアジア向け売上高比率も年々増加しており、アジアを中心とした海外市場の重要性はますます高まっています。

この環境変化に的確に対応するため、現在フジミではアメリカに加え台湾でも製造、販売機能と研究開発機能を併せ持つことで、お客様のニーズにより早くより正しく対応できる一貫体制を構築しています。

フジミのグローバルネットワーク



フジミの地域別売上高（通期）



国際半導体技術ロードマップ
世界中の主な半導体関連組織や識者が集まって作る半導体関連の技術ロードマップ(将来展望)。今後の15年程度にわたっての詳細なロードマップが示され、毎年更新されている。

これにより、お客様のニーズに的確にお応えできる製品やサービスを迅速に提供することで、お客様の満足を実現できると考えます。

また、お客様の満足を最優先に考えることでお客様に喜んでいただき、その結果として、信頼を獲得できるものと考えます。

海外市場展開をする上で、グローバルな人材の育成と活用がポイントとなります。それは国内の従業員に国際人として活躍してもらう事と現地の優秀な人材に活躍してもらう事です。いずれの人材も、お客様とどこまで密接にコミュニケーションできるかが重要な課題です。

また、行動の拠り所となる“企業理念や企業ビジョン”の共有は、海外市場展開をさらに進めていく上で重要なカギとなります。

国内では、改めて企業理念や企業ビジョンを共有する重要性を認識し、“お客様の満足”を常に考え、お客様の視点に立って行動することの再徹底が行われています。

１９８４年にフジミが初めて海外進出したアメリカでは、１０年以上フジミグループの一員として勤めている現地従業員も増えてきており、長期にわたり共に働くことで、現在ではフジミらしさが一部共有されつつありますが、フジミグループとしての企業理念・企業ビジョンの浸透が十分に図られているわけではありません。

何より重要なことは、子会社の国や地域の文化・風習・考え方などを取り込みつつ、グローバルとローカルを融合させて企業理念・企業ビジョンの共有を図ることです。

また、組織面においては、日本に独立した組織としてプロダクトサポート室を設置し、「営業、開発、資材、製造、品質保証」などの業務を各部門と連携して迅速に対応することが可能となっており、台湾子会社においても同じ組織を導入することにしました。これは、海外市場展開のスピードアップに伴い、さらなるお客様へのサービスと品質の向上を目指す具体的施策のひとつです。

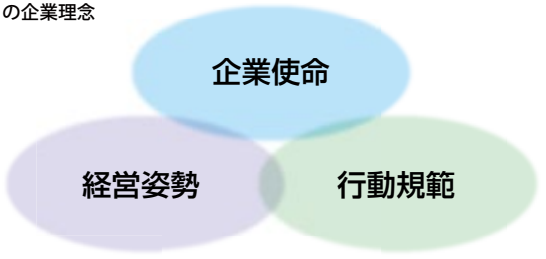
国内だけでなく海外での活動においては、お客様と個別に技術的な諸問題について検討する**TRM**（Technology Review Meeting）を積極的に行っています。これは最新の製品紹介や、お客様からの技術的な要望などにお答えする場となっています。それがきっかけで、お客様の商品をお預かりしてデモンストレーションを行うことにつながる場合もあります。このような活動はいずれも現地に設備などのインフラを整備することで、お客様へのより効果的なプロモーションを可能としており、お客様との信頼関係づくりに貢献しています。


R&Dセンターでの打合せ


R&Dセンタークリーンルーム

TRM (Technology Review Meeting)
技術的な諸問題をお客様と個別に検討する打合せ。

フジミの企業理念



企業使命
高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢
- お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- 経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- 技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範
- お客様の満足を常に考え行動します。
- 問題の本質を追究し、迅速かつ確実に解決します。
- 夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- 良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

FUJIMI TAIWAN LIMITED —台湾—

台湾での販売・製造拠点の確立

台湾事務所としてスタートした台湾での事業は、２０１１年８月、現地化を一段と推進するため、台湾現地法人としてフジミ台湾を設立しました。

台湾苗栗縣銅鑼鄉にある科学開発区内に、生産・研究開発・管理機能を統合した建屋の建設を開始、関係各位の全面的なご支援をいただき、２０１２年１０月に無事完成いたしました。

１０月２９日にはフジミ本社の関係者に加え、お客様、取引先、政府関係者および業者各位をお招きして開所式を挙行、１００名近くの来賓の方々にお越しいただき、成功裏に終えることができました。

フジミ台湾では、台湾でのＣＭＰ製品の開発、製造および販売を担う計画です。

台湾の半導体製造のお客様に現地で生産したＣＭＰ製品をいち早くお届けし、研究開発・プロダクトサポートも含めたお客様の視点に立った体制を構築することによって、お客様のより良い製品づくりに貢献していきたいと考えています。



開所式


FUJIMI TAIWAN LIMITED

台湾で研究開発＆製造販売するメリット

日・米・欧の３極体制が長く続いてきた半導体業界ですが、近年、世界経済が大きく揺れ動く中で、半導体業界の地図は徐々に塗り替えられつつあります。台湾では、早くから従来の重工業中心から半導体・液晶パネルなどのハイテク分野への投資に舵を切りました。海外からの投資を誘致し、その結果、日・米・欧のシリコンウェハーメーカーや化学会社が進出しています。

同時に、台湾政府の支援もあって、台湾での半導体製造関連事業は急成長しており、その技術力は高く評価されています。

また、台湾の**ＧＤＰ**に占めるＩＴ製品の輸出比率は７割を超え台湾の輸出額はＩＴ景気の先行指標とも言われるようになるほど成長してきました。

このような経済環境の中で、ＣＭＰ製品にフォーカスして、台湾

GDP（Gross Domestic Product:国内総生産）
国内で、1年間に新しく生みだされた生産物やサービスの金額の総和。

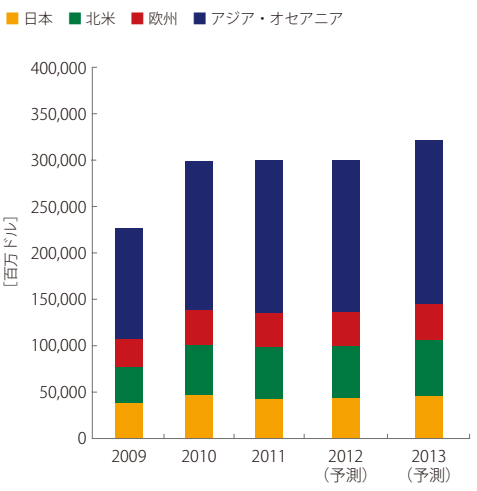
にフジミの研究開発・製造・販売の拠点を設けることは、今後さらに成長が期待されるだけでなく、フジミの世界戦略拠点を進める上で重要な意味を持つものといえます。

今後を見据えて

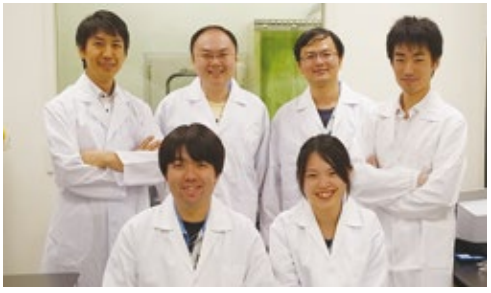
私たちはお客様のスピードに応え、高品質な製品を安定的に提供いたしますが、お客様の製品の低価格化に伴い、お客様からの価格面のリクエストにどのように対応していくかも今後の課題のひとつです。そのためにリサイクル可能な製品の開発や排水処理しやすい製品を開発するなど、お客様の顕在化したニーズに加え、潜在的なニーズをも把握し、製品やサービスの提供に努めていきます。

FUJIMI TAIWAN LIMITED
設立：2011 年 8 月　従業員数：31 名（2012 年 9 月 30 日現在）

WSTS 2012年春季半導体市場予測（世界地域別）



出典：WSTS 日本協議会


研究開発部門の従業員


研究風景

台湾ちょっとメモ　Written by 木村 佳央（FUJIMI TAIWAN LIMITED）
Staff Voice from Taiwan

フジミ台湾の木村と申します。当子会社は、日本人15名と台湾人16名による、国際色豊かな構成です。建屋・設備等は整い、今後は以下の点に尽力していきます。

1. 日本の緻密さと台湾のエネルギッシュさを融合し、新たな文化を醸成していくこと。
2. お客様との距離の近さを最大限に活かし、お客様のニーズを肌で感じ、素早く対応すること。

今後の我々の活躍に、ぜひご期待ください。





FUJIMI CORPORATION —アメリカ—

アメリカでの販売・製造拠点の確立と歩み

１９８４年に販売会社としてフジミコーポレーションをイリノイ州に設立しました。その４年後の１９８８年に製造拠点としてフジミアメリカをオレゴン州に設立し、１９９６年にはオレゴン州トゥアラタン市に新たな製造拠点を設けました。

１９９９年にフジミコーポレーションは、フジミインコーポレーテッド（日本）の完全子会社となり、２００３年にフジミアメリカと統合、社名をフジミコーポレーションとして、現在にいたっています。

アメリカ市場におけるフジミの事業展開

フジミコーポレーションは、主に半導体デバイス向けのＣＭＰスラリーやシリコンウェハー用のラッピング材を製造しています。販売においてはフジミ製品全般を取り扱っており、米国の大手半導体メーカーやシリコンウェハーメーカー等の半導体業界のお客様をはじめとして、光学・水晶・ステンレス材料などの加工業界・産業分野のお客様へ各種ラッピング材やポリッシング材を納入しています。

昨今、スマートフォンやタブレット端末市場の拡大に加え、クラウド化の進展等により、データセンターやサーバー市場向けの半導体製造メーカー等のお客様への販売が好調となっています。



打合せ風景

アメリカ市場におけるフジミの強み

フジミコーポレーションで製造しているＣＭＰスラリーは、最先端の半導体製造工程の中でも特にお客様の製品価値を決める重要な工程で使用されています。それは、変化の激しい半導体市場において、製品開発競争にしのぎを削っているお客様に認めていただいた結果であり、技術で先頭を走り続けていることがフジミの強みであります。

近年、研磨対象が原子レベルの領域に入り、従来技術の延長だけではお客様の満足を得ることが難しくなってきました。このような状況下、日本のコア技術開発をベースにアメリカのお客様の個々のニーズにあった組成開発を行うことが重要です。

その点においても、お客様のすぐそばに研究・開発・製造拠点を置いているフジミコーポレーションの立地も、強みの一つであるといえるでしょう。



研究開発の打合せ





製品販売のみならず研究開発から生産設備を備えた拠点

FUJIMI CORPORATION
設立：1984 年 6 月　従業員数：104 名（2012 年 9 月 30 日現在）

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN BHD. —マレーシア—

お客様に必要な製品をタイムリーに供給

フジミマイクロテクノロジーは、マレーシアの首都クアラルンプールに事務所を、ケダ州クーリム地区に製造拠点を構えています。

マレーシアは、ハードディスク関連メーカーの生産拠点が集中しており、クーリム工場では、ハードディスク向け製品を主に製造しています。

ハードディスク関連メーカーのお客様のすぐそばで製造することで、お客様に必要な製品をタイムリーに供給する体制を構築しています。お客様の製品のモデルチェンジに対する素早い対応と安定供給を実現し、お客様から高い信頼を得ることができています。

また、さまざまな国籍のお客様に的確に対応するため、マレー語・中国語・英語・日本語で会話ができる人材を多数配置しています。


打合せ風景


さまざまな言語に対応する従業員

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
設立：1995 年 4 月　従業員数：62 名（2012 年 9 月 30 日現在）

FUJIMI EUROPE GmbH —ドイツ—

お客様との親密な関係の構築

フジミヨーロッパは、ドイツのインゲルフィンゲンに販売拠点を構えています。主に半導体**ファウンドリ**、半導体メーカー、シリコンウェハーメーカーのお客様に対し、シリコンウェハー用ラッピング材・ポリシング材、ハードディスク用ポリシング材やＣＭＰスラリーの販売拠点として、頻繁にお客様を訪問することでお客様と親密な関係を築き、売上拡大に力を注いでいます。

そして、迅速かつプロフェッショナルなお客様対応によりフジミ製品の信頼性を高め、さらなるフジミブランドの浸透を図っています。同時に、それらの活動から得たフジミヨーロッパのお客様ニーズを研究・開発部門へフィードバックし、競争力のある製品開発へとつなげることも、我々の重要な役割のひとつだと捉えています。


プロフェッショナルなお客様対応を行う従業員

FUJIMI EUROPE GmbH
設立：2004 年 1 月　従業員数：5 名（2012 年 9 月 30 日現在）

ファウンドリ
半導体デバイス(半導体チップ)を受託生産する企業や工場。

用途別の動き

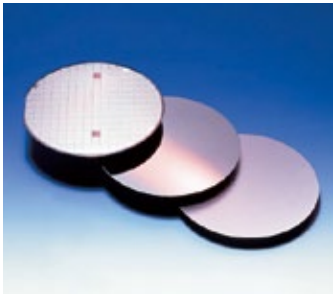
暮らしを楽しく、便利にするパソコン、スマートフォン、液晶テレビなどのデジタル家電。この心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右する重要なポイントです。フジミは、人造研磨材の専門メーカーとして、シリコンウェハーや半導体デバイスの製造工程に欠かせない研磨の分野で、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献していきます。



シリコンウェハー用

●売上高：4,843百万円
●前年同期比：13.2%減

パソコンを中心に、電子・IT関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社の主力事業であるシリコンウェハー用製品では、お客様の期待に応える商品開発をタイムリーに行い、品質の高い新製品をいち早く市場に投入してまいります。

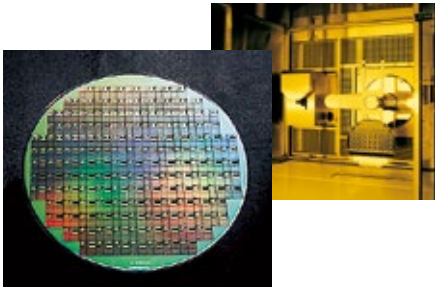


半導体の基板であるシリコンウェハー。現在の主流は、直径300mmの大口径となり、表面を高精度に磨き上げるために当社の超精密研磨材が使われています。

CMP用

●売上高：4,399百万円
●前年同期比：11.3%増

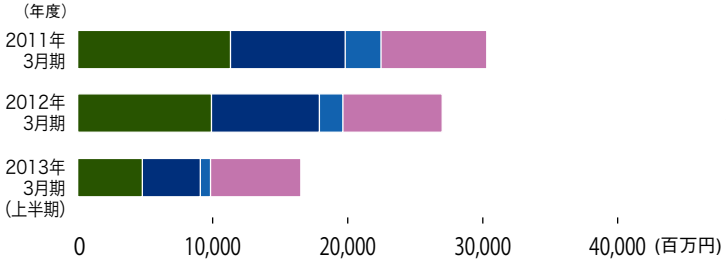
エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。CMP（化学的機械的平坦化）用製品群は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用し開発され、多層配線技術に対応しています。お客様のロードマップにあった迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、マーケットシェアの拡大を目指してまいります。



さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細かくなっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10～12層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かすことができません。

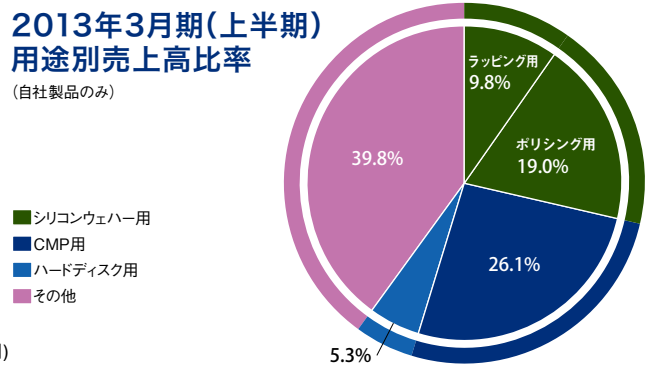
用途別製品売上高推移

※グラフは商品を含めない自社製品のみの売上高です。



2013年3月期（上半期）用途別売上高比率

（自社製品のみ）



ハードディスク用

●売上高：887百万円
●前年同期比：2.7%減

ハードディスクは、パソコンの記憶装置としてはもちろん、ブルーレイディスク（BD）/DVDレコーダー、デジタルビデオカメラ、携帯音楽端末、カーナビなどにも搭載されており、最近ではクラウド向けの用途が拡大しております。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、ディスクの表面研磨は、シリコンウェハー同等もしくはそれ以上の面精度が要求されています。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求にあった新製品をタイムリーに提供してまいります。





写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラなどのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。

その他の用途

●売上高：6,724百万円
●前年同期比：67.4%増

ワイヤーソー用砥粒は、単結晶・多結晶のシリコンインゴット（塊）を厚さ１ミリ未満のウェハーに切断するために使用され、主にシリコンウェハーの切断や太陽電池用シリコンの切断に使われています。

溶射材は鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界の溶射用途向けに、主にサーメット溶射材とセラミック溶射材を提供しています。

LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野や、パウダー技術を活かした応用分野への研磨・研削材の開発にも積極的に取り組んでおります。最近では、新規用途の一般工業用研磨材の売上が拡大しており、トータルソリューションの提供によりお客様の信頼を得ております。

連結財務諸表

（単位：百万円）

連結損益計算書	2012年3月期（通期）	2012年3月期（上半期）	2013年3月期（上半期）
売上高	27,424	14,631	16,959
売上原価	19,399	10,254	10,542
販売費及び一般管理費	7,070	3,375	3,675
営業利益	953	1,001	2,740
営業外収益	136	77	74
受取利息／配当金	63	31	31
その他	72	46	43
営業外費用	51	57	68
支払利息	5	3	0
その他	46	53	68
経常利益	1,038	1,022	2,746
特別利益	6	2	3
特別損失	63	2	—
税金等調整前上半期（当期）純利益	980	1,022	2,749
法人税、住民税及び事業税	157	299	1,202
法人税等調整額	260	25	△179
少数株主利益	19	8	12
上半期（当期）純利益	543	688	1,714

※通期は4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。

売上高

半導体市場は、従来型パソコンや薄型テレビ等の最終製品の販売不振の影響を受け減速傾向となったものの、非半導体関連の新規海外需要が順調に拡大した結果、売上高は前年同期比15.9%増の16,959百万円となりました。

営業利益

売上高の増加に加え、それに伴う工場稼働率の向上やコスト削減効果などにより、営業利益は前年同期比173.6%増の2,740百万円となりました。

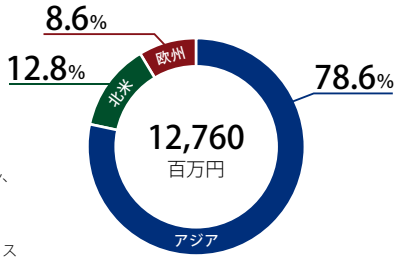
上半期純利益

営業利益の増加などにより、前年同期比149.1%増の1,714百万円となりました。

（単位：百万円）

海外売上高	2012年3月期（上半期）	2013年3月期（上半期）
海外売上高	9,615	12,760
連結売上高	14,631	16,959
連結売上高に占める割合	65.7%	75.2%

海外売上高構成比
（2013年3月期上半期）



※各区分に属する地域の
主な内訳は次のとおりです。
■アジア：台湾、タイ、シンガポール、
マレーシア、韓国、中国
■北　米：アメリカ、カナダ
■欧　州：ドイツ、イタリア、イギリス

（単位：百万円）

連結貸借対照表	2012年3月期（通期）	2012年3月期（上半期）	2013年3月期（上半期）
資産の部			
流動資産	28,506	30,324	31,361
現金及び預金	9,490	10,847	11,991
受取手形及び売掛金	6,504	7,093	7,886
たな卸資産	6,241	5,768	5,742
その他	6,311	6,775	5,792
貸倒引当金	△41	△160	△51
固定資産	15,875	15,991	15,977
有形固定資産	13,970	13,581	13,926
無形固定資産	462	298	562
投資その他の資産	1,442	2,111	1,488
資産合計	44,381	46,315	47,338

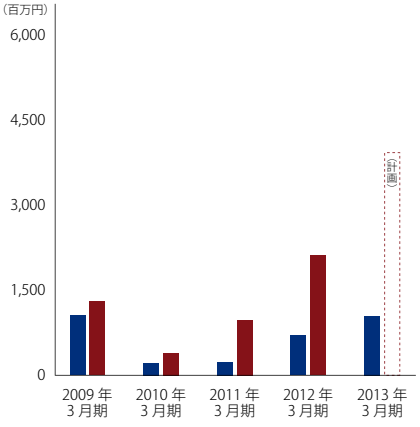
※通期は年度末の3月31日現在。上半期は9月30日現在。

（単位：百万円）

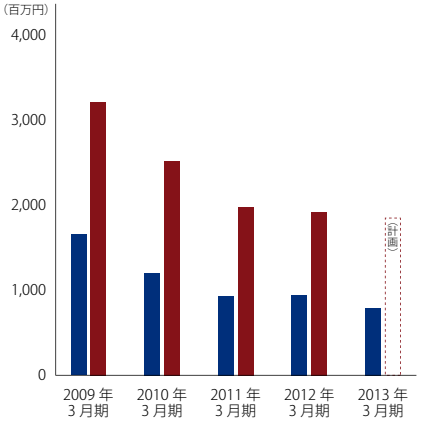
連結貸借対照表	2012年3月期（通期）	2012年3月期（上半期）	2013年3月期（上半期）
負債の部			
流動負債	5,523	5,922	7,460
支払手形及び買掛金	3,082	3,519	3,405
短期借入金	41	76	—
その他	2,400	2,325	4,054
固定負債	214	172	219
負債合計	5,737	6,095	7,680
純資産の部			
株主資本	39,828	41,931	41,153
資本金	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	35,716	36,274	37,041
自己株式	△5,711	△4,166	△5,711
その他の包括利益累計額	△1,475	△1,968	△1,781
新株予約権	59	60	56
少数株主持分	231	198	230
純資産合計	38,643	40,220	39,658
負債純資産合計	44,381	46,315	47,338

上半期　通期　通期実績　通期計画

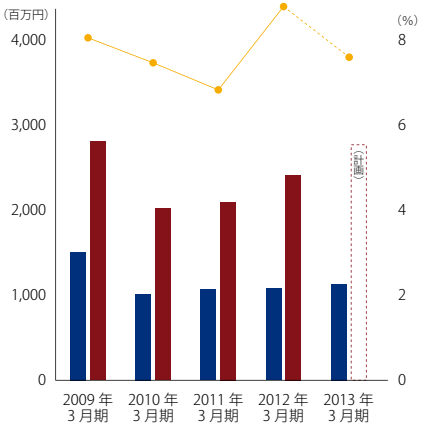
■設備投資額



■減価償却費



■研究開発費・対売上高比率



連結財務諸表

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて3,557百万円増加し、3,746百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加及びたな卸資産の減少により資金の増加があったこと等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べて621百万円増加し、1,788百万円となりました。これは、主に有価証券の取得による支出が増加したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

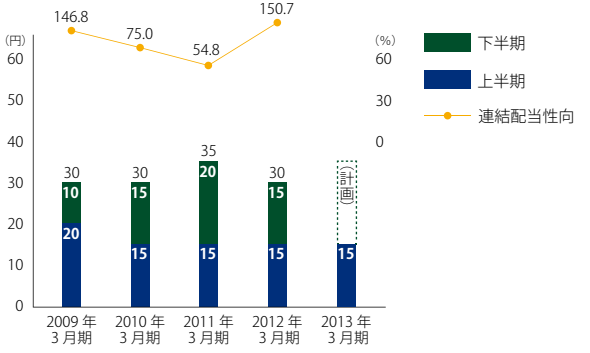
財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて545百万円減少し、432百万円となりました。これは、前年同期に自己株式の取得を実施したこと等によるものです。

配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては、安定配当にも留意し30%以上の連結配当性向を目標とし、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいりました。このような方針のもと、当期末配当金は、業績予想の修正をふまえ期末配当金を15円から5円増配し 1 株につき20円とし、年間配当金は1株につき35円とする予定です。

連結キャッシュ・フロー計算書	2012年3月期（通期）	2012年3月期（上半期）	2013年3月期（上半期）
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,162	189	3,746
税金等調整前上半期（当期）純利益	980	1,022	2,749
減価償却費	1,921	909	780
売上債権の増減額（△は増加）	130	△ 229	△ 1,542
仕入債務の増減額（△は減少）	26	632	436
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,161	△ 857	361
その他	98	△ 770	719
小計	1,996	705	3,505
利息及び配当金の受取額	64	29	32
法人税等の支払額	△ 892	△ 540	△ 132
その他	△ 5	△ 4	341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,876	△ 1,167	△ 1,788
定期預金の預入による支出	△ 2,615	△ 2,008	△ 1,604
定期預金の払戻による収入	2,508	1,505	1,002
有価証券の取得による支出	△ 800	—	△ 1,000
有価証券の償還による収入	—	—	800
有形固定資産の取得による支出	△ 1,707	△ 617	△ 815
無形固定資産の取得による支出	△ 267	△ 48	△ 166
その他	4	1	△ 4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,980	△ 977	△ 432
長期借入金の返済による支出	△ 79	△ 39	△ 39
自己株式の取得による収支	△ 1,918	△ 373	△ 0
配当金の支払額	△ 971	△ 558	△ 389
その他	△ 11	△ 5	△ 3
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 146	△ 327	△ 125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 4,841	△ 2,282	1,400
現金及び現金同等物の期首残高	16,265	16,265	11,579
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	155	155	—
現金及び現金同等物の期末残高	11,579	14,139	12,980

※4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。



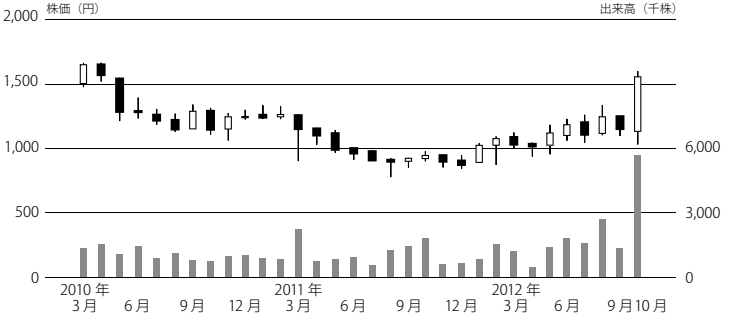
株式情報 2012年9月30日現在

株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000千株
	発行済株式総数	30,699千株
	株主数	6,527名

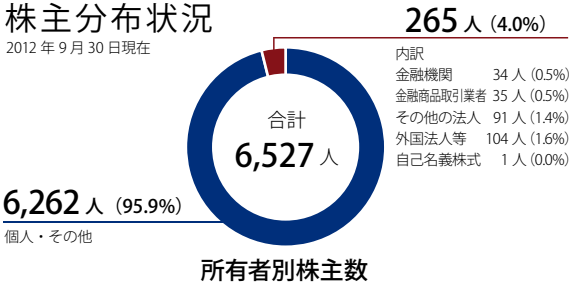
大株主（株主名）	**持株数（千株）**	**持株比率（%）**
株式会社フジミインコーポレーテッド（自己株口）	4,760	15.5
越山　勇	2,902	9.4
有限会社コマ	1,638	5.3
野田　純孝	1,520	4.9
越山　彰	1,151	3.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	987	3.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	979	3.1
日本生命保険相互会社	779	2.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	728	2.3
株式会社りそな銀行	691	2.2

株価および出来高の推移

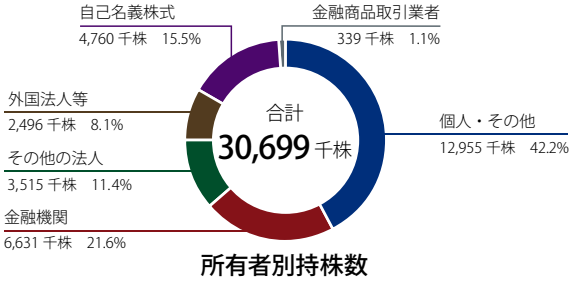


株主分布状況

2012年9月30日現在



所有者別株主数



所有者別持株数

役員

2012年
9月30日現在

代表取締役社長	関　敬史
常務取締役	伊藤　広一
取締役	土屋太加志
取締役	鈴木　彰
取締役	大脇　寿樹
取締役	鈴木　勝弘
常勤監査役	石井　和廣
常勤監査役	松島　伸男
監査役	髙橋　正彦
監査役	川下　政美

会社データ

2012年9月30日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181（代表）
設立年月日	1953年（昭和28年）3月20日
資本金	47億5,343万8,500円
代表者	代表取締役社長　関　敬史
従業員	760名（個別588名）

株主メモ

2012年9月30日現在

決算日	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告（http://www.fujimiinc.co.jp） ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
郵便物送付先および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 電話　0120-232-711（通話無料）

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

  証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。

  証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関　日本証券代行株式会社
連絡先　〒137-8650
東京都江東区塩浜二丁目8番18号
電話　0120-707-843
（通話無料）

株式会社フジミインコーポレーテッド
お問い合わせ先：経営企画部企画課
TEL：052-503-8181（代表）
URL：http://www.fujimiinc.co.jp

Copyright (C) 2012 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

VEGETABLE OIL INK
古紙パルプ配合率5%再生紙を使用
適切に管理された森林から切り出された木材を使用しています

この印刷物は、環境負荷低減のため適切に管理された認証パルプと古紙パルプを5%以上使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。